



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

HTG-300SF 常规系列

【无硅导热凝胶】规格书



-产品图-

应用特点：

- 高导热性能，低热阻
- 低压力下应用
- 无硅油挥发，无污染
- 良好的电绝缘性能和耐高温性能

应用领域推荐：

- 半导体块和散热器
- 光学精密设备
- 汽车电子
- LED、医疗电子
- 高性能中央处理器及显示卡处理器

应用方式：

无硅导热凝胶可通过各种方式使用，包括：自动点胶、模版印胶和手动涂覆。

包装：

根据不同需求，可以按照30cc/55cc/300cc等容量，按灌注方式包装。

该系列产品环保符合ROHS2.0、卤素、REACH标准。

储存条件：

阴暗处储存，
储存温度：≤25℃；
储存湿度：≤70%

保质期：

在储存条件下：6个月
不符合储存条件下：3个月

鸿富诚 HTG-300SF 系列, 无硅导热凝胶是一种不含低分子硅氧烷的热界面材料, 无硅油挥发, 不污染元器件, 适用于对硅油敏感的场所。无硅导热凝胶对厚度无敏感性, 在设备组装过程中具有良好的自适应性, 兼容相关器件或结构件在尺寸公差上带来的影响。

产品性能			
NO.	参数	单位	测试方法
颜色	白色	--	目视
密度	3.11(±0.5)	g/cc	ASTM D 792
挤出速率 @0.6Mpa	10(±3)	g/min	GB/T29755-2013
瞬间压缩应力	≤40 (@50Psi)	%	GB/T 7757-2009
静态压缩应力	≤1 (@50Psi)	%	GB/T 7757-2009
粘接力	≤15	Psi	--
固化时间	50℃	480	min
	100℃	70	min
	120℃	40	min
室温操作时间	≤180	min	--
针入度	24(±3)	mm	GB/T 4985-2010
使用面积	@1 mil thickness	15.5	cm ² /g
	@2mil thickness	7.75	cm ² /g
	@5 mil thickness	3.1	cm ² /g
	@10 mil thickness	1.55	cm ² /g
使用温度	-50~150	℃	IEC 60068-2-14
热学特性			
导热系数	3.0(±0.25)	W/m-K	ASTM D 5470
热阻	≤0.07 (@20psi/1mm)	°Cin ² /W	ASTM D 5470
电学特性			
击穿电压	≥8	KV/mm	ASTM D149
体积电阻率	≥10 ⁸	Ω.cm	ASTM D 257

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权